

一般社団法人ニューダイヤモンドフォーラム  
平成30年度第3回研究会  
プログラム

日 時： 平成31年3月1日（金） 研究会 13：30－16：50  
懇親会 17：00－

場 所： 東京工業大学 大岡山キャンパス石川台3号館  
（〒152-8550 東京都目黒区大岡山 2-12-1）  
研究会： 304号室、 懇親会： 305号室  
<http://www.titech.ac.jp/maps/>

テーマ：「ダイヤモンド・cBN 工具による難削材切削加工の基礎と応用」

プログラム

－研究会－

- 13:30～14:15 (1) 材料特性から見た被削性  
広島大学 特任教授 山根 八洲男 氏
- 14:15～15:00 (2) 難削材切削加工の基礎  
東京電機大学 特別専任教授 帯川 利之 氏
- 15:00～15:20 休 憩
- 15:20～16:05 (3) CFRP 加工用ダイヤモンド被膜工具について  
オーエスジー(株) 稲吉 宏文 氏
- 16:05～16:50 (4) ダイヤモンド・cBN 工具による難削材加工について  
住友電工ハードメタル(株) 久木野 暁 氏

－懇親会－

17:00～